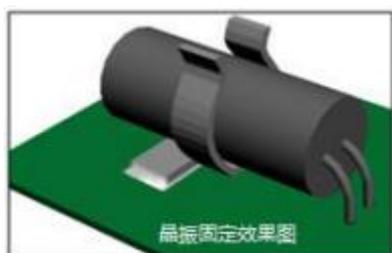


### 概述:

本产品是我公司为改善圆柱形  $\phi 2 \times 6$  封装石英晶体（如 32.768kHz）的加工工艺，提高加工效率及晶体使用可靠性而设计。已获得国家专利授权。

专利号：ZL 2013 2 0571186.7

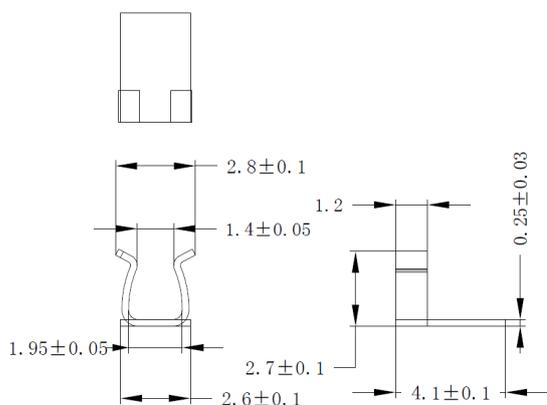


### 特点:

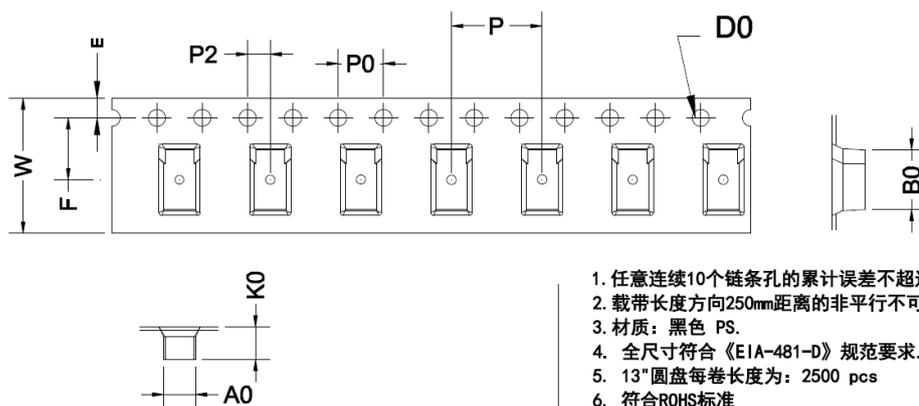
- 可有效避免传统导线箍的加工工艺可能产生的变形、松紧不适以及由此产生的颠震损坏；
- 可有效减少晶体导线箍焊接时烙铁的停留时间，避免高温带来的晶体损坏等影响；
- 可有效避免传统胶合加工工艺可能造成的接地不良；
- 贴片封装，卡合工艺，提高了晶体焊接环节的生产效率；
- 材料使用磷铜 C5191，表面镀亮锡，具有良好的导电性、延展性、耐腐蚀、耐磨损，可保证接触可靠、拔插平稳。

### 外形尺寸:

本产品具体尺寸如下(单位 mm):



载带尺寸(单位 mm): 2500PCS/盘

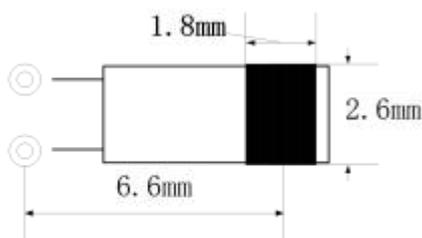


1. 任意连续10个链条孔的累计误差不超过 $\pm 0.2\text{mm}$ 。
2. 载带长度方向250mm距离的非平行不可超过1mm。
3. 材质：黑色 PS。
4. 全尺寸符合《EIA-481-D》规范要求。
5. 13"圆盘每卷长度为：2500 pcs
6. 符合ROHS标准

W	16.00±0.30	P	8.00±0.10	A0	2.80±0.10	B0	5.30±0.10
S	0.00±0.10	P0	4.00±0.10	A1		B1	
E	1.75±0.10	P2	2.00±0.10			B2	
F	7.50±0.10	D0	∅1.50 <sup>+0.10</sup> <sub>0</sub>	K0	2.90±0.10	K1	
T	0.40±0.05	D1					

推荐焊盘尺寸：

本产品推荐焊盘尺寸如下(单位 mm)：



推荐焊盘

组装流程图：

该物料的焊盘位置设计、焊接方向及组装流程等，建议参考如下图示进行：

序号	环节	图示
1	晶体座贴片	
2	晶体座回流焊	
3	晶体插件	
4	晶体卡合	
5	晶体脚焊接	

**贴装要求：**务必按《iH2603B(2S)石英晶体固定座 SMT 焊接工艺说明 V1.5》进行。